华林证券股份有限公司

华林投行[2019] 75 号

关于无锡芯朋微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“本保荐机构”）及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

第一节　本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及其他项目人员情况

成员	姓名	保荐业务执业情况
保荐代表人	陈坚	曾负责或参与冰川网络（300533）、麦格米特（002851）等 IPO 项目，华伍股份（300095）、美盛文化（002699）等再融资项目，智慧松德（300173）、麦格米特（002851）等重大资产重组项目。
	黄萌	曾负责或参与澳洋顺昌（002245）、禾盛新材（002290）、东山精密（002284）、天马精化（002453）、春兴精工（002547）、苏大维格（300331）、世嘉科技（002796）、苏州科达（603660）等 IPO 项目。
项目协办人	卞大勇	曾负责或参与天泽信息（300209）、亚玛顿（002623）IPO 审计及年报审计项目，视觉中国（000681）上市公司年报审计及重大资产重组审计项目。
项目组其他成员	钟昊、易慧敏、韩志强、夏菁、王冲、李兴亮	

二、发行人基本情况

公司名称：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”、“发行人”或“公司”）

住所：无锡新吴区龙山路 2-18-2401、2402

成立日期：2005 年 12 月 23 日

联系电话：0510-85217718

传真号码：0510-85217728

经营范围：电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务；自营各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

证券发行类型：首次公开发行股票并在科创板上市。

三、保荐机构与发行人的关系

发行人股票曾在全国中小企业股份转让系统做市转让，华林证券为芯朋微提

供做市报价服务。截至本发行保荐书出具之日，“华林证券股份有限公司做市专用证券账户”持有芯朋微 152.12 万股，占芯朋微发行前总股本的 1.80%。

除上述情形外，本保荐机构与发行人不存在下列情形：

一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

四、保荐机构内部审核程序及内核意见

（一）内部审核程序

本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目履行了严格的内部审核流程：

1、立项审核：2019 年 3 月 12 日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审核，同意立项。

2、内部核查部门审核：2019 年 10 月 28 日至 11 月 1 日，本保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。

本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。

3、问核：2019 年 11 月 6 日，本保荐机构保荐业务负责人、保荐业务部门负责人、内核部主审人员对保荐代表人陈坚、黄萌就《关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表》的重要事项尽职调查情况进行了问核，并形成了问核意见。

本保荐机构项目组对问核意见进行了逐项回复。

4、内核小组审核：本保荐机构内核小组于 2019 年 11 月 12 日召开内核会议，对发行人首次公开发行股票并在科创板上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小组成员对发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核小组成员提出的问题进行了逐项回答。

内核小组经投票表决，审议通过了本项目。

本保荐机构项目组对内核会议意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核会议意见落实情况进行了检查。

（二）内核意见

本保荐机构内核会议经充分讨论，形成如下意见：发行人首次公开发行股票符合相关法律法规的要求，相关申请文件未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意推荐发行人首次公开发行股票并在科创板上市。

第二节　保荐机构承诺事项

本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行并在科创板上市，并据此出具本发行保荐书。

本保荐机构就如下事项做出承诺：

一、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并在科创板上市的相关规定；

二、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

三、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

四、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

五、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

六、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

七、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

八、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

九、遵守中国证监会规定的其他事项。

第三节　保荐机构对本次证券发行的推荐意见

本保荐机构已按照中国证监会的有关规定进行了充分的尽职调查、审慎核查。

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论

本保荐机构作为无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，在进行充分尽职调查、审慎核查的基础上，认为无锡芯朋微电子股份有限公司具备《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件中规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件，同意保荐其首次公开发行股票并在科创板上市。

二、关于本次证券发行的决策程序

（一）发行人于 2019 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，对本次股票发行的具体方案、本次募集资金投资项目的运用计划、发行前滚存利润的分配方案、发行上市后的现金分红政策、上市后适用的《公司章程（草案）》及其他必须明确的事项作出了决议。

（二）发行人于 2019 年 10 月 29 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议并通过了关于本次股票发行上市的有关决议，包括：本对本次股票发行的具体方案、本次募集资金投资项目的运用计划、发行前滚存利润的分配方案、发行上市后的现金分红政策、上市后适用的《公司章程（草案）》、决议的有效期、对董事会办理本次发行具体事宜的授权等。

经核查，本保荐机构认为：发行人已就本次股票发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序。

三、关于《证券法》规定的发行条件

（一）发行人已具备健全且运行良好的组织机构；

（二）发行人具有持续盈利能力，财务状况良好；

（三）发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为。

经核查，本保荐机构认为：发行人符合《证券法》规定的发行条件。

四、关于《注册管理办法》规定的发行条件

（一）发行人符合《注册管理办法》第十条的规定

本保荐机构调阅了发行人的工商档案，确认发行人为成立于 2005 年 12 月 23 日的有限责任公司，并于 2011 年 11 月 30 日按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，发行人依法设立，且持续经营三年以上。

经核查，本保荐机构认为：发行人符合《注册管理办法》第十条的规定。

（二）发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定

1、本保荐机构查阅了发行人相关财务管理制度，确认发行人会计基础工作规范；根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，确认发行人财务报表的编制符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。

2、本保荐机构查阅了发行人内部控制制度文件，访谈了发行人董事、监事、高级管理人员，与会计师进行了沟通，取得了发行人的《内部控制自我评价报告》和会计师出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》，确认发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。

经核查，本保荐机构认为：发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定。

（三）发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定

1、本保荐机构深入了解发行人的商业模式，查阅了发行人主要合同、实地走访了主要客户及供应商，与发行人主要职能部门、高级管理人员和主要股东进行了访谈，了解了发行人的组织结构、业务流程和实际经营情况，核查了主要股东及其控制的其他企业，核查了关联交易的必要性和公允性，确认发行人资产完

整，业务及人员、财务、机构独立，与主要股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、本保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东大会决议和记录，查阅了工商登记文件，查阅了发行人财务报告，了解了发行人的组织结构、业务流程和实际经营情况，确认发行人主营业务、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

3、本保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术、商标、专利、集成电路布图等权属文件，向银行取得了发行人相关信用记录文件，核查了发行人相关的诉讼和仲裁文件，查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，访谈了发行人高级管理人员，核查分析了发行人的经营资料、财务报告和审计报告，确认发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

经核查，本保荐机构认为：发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定。

（四）发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定

1、本保荐机构查阅了发行人章程，查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，访谈了发行人高级管理人员，查阅了发行人生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所，确认发行人的生产经营活动符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

2、本保荐机构取得了相关有权部门出具的发行人及其控股股东、实际控制人无违规的证明文件，确认最近 3 年内发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安

全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

3、本保荐机构查阅了证监会、证券交易所的网站，访谈发行人董事、监事和高级管理人员，取得了相关人员的声明文件，确认发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

经核查，本保荐机构认为：发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定。

综上所述，本保荐机构认为：本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件。

五、关于发行人股东中涉及的私募投资基金备案情况

经核查，本保荐机构认为：发行人股东中涉及的私募投资基金均履行了备案程序，符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》要求。

六、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营情况

经核查，本保荐机构认为：财务报告审计截止日至本发行保荐书签署日，发行人主要经营情况正常，未发生影响投资者判断的重大事项。

七、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》有关事项的情况

经核查，本保荐机构认为：发行人所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，亦符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。

八、关于聘请第三方情况的说明

本次保荐工作过程中，本保荐机构不存在《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》文件中所述聘请第三方的行为。

本保荐机构对芯朋微有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，芯朋微在本次发行上市中除保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外，聘请了深圳市寰宇信德信息咨询有限公司作为行业研究与咨询机构，相关聘请行为合法合规。

九、关于发行人存在的主要风险

经核查，本保荐机构认为发行人在生产经营中面临如下主要风险：

（一）财务风险

1、应收账款余额较高的坏账风险

报告期各期末，随着公司销售规模的持续增长，应收账款余额逐年增长，各期末应收账款账面余额分别为 6,312.02 万元、7,226.00 万元、8,414.37 万元和 8,713.99 万元，占各期营业收入的比例分别为 27.50%、26.33%、26.94%和 37.47%，占比基本稳定。公司主要客户资信状况良好，应收账款周转率处于行业中间值，随着公司经营规模的扩大，应收账款期末余额预计逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户经营不善导致无法及时回收货款，公司的坏账风险将会增加。

2、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,641.05 万元、3,745.50 万元、6,281.54 万元和 7,019.40 万元，各期末占公司资产总额的比重分别为 14.63%、13.76%、19.19%和 14.15%，为公司的主要流动资产。公司根据对未来一定周期内市场需求及公司销售状况的预测提前制定采购及生产策略，并不断根据市场需求变化情况动态调整安排采购、生产计划，保证了公司合理的库存水平。报告期内，公司存货周转率分别为 4.10 次、4.14 次、3.46 次和 2.55 次，略高于同行业平均水平。但如果公司无法准确预测市场需求、设置适当的安全库存，将导致存

货跌价的风险。

3、税收优惠、政府补助不能持续的风险

报告期内，发行人享受税收优惠的金额分别为 340.52 万元、845.76 万元、842.67 万元和 757.61 万元，占当期利润总额的比例分别为 9.68%、16.43%、13.80%和 15.79%，主要为重点集成电路设计企业所得税税收优惠。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号），发行人符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，2019 年 1-9 月按照 10%的优惠税率预缴企业所得税。如果重点集成电路设计企业税收优惠无法延续，2019 年 1-9 月按法定企业所得税税率 25%计算，发行人 2019 年 1-9 月当期所得税将增加 757.61 万元，占当期利润总额的比例为 15.79%。若发行人重点集成电路设计企业资格不能持续获得，或者重点集成电路设计企业所得税税收优惠幅度减少或取消，将对发行人的盈利能力产生一定不利影响。

报告期各期，发行人政府补助对利润总额的贡献分别为 767.21 万元、900.01 万元、597.10 万元和 403.63 万元，占当期利润总额的比例分别为 21.81%、17.48%、9.78%和 8.41%。虽然政府补助记入发行人非经常性损益，且发行人行业属于政策支持行业，近年来发行人获得的政府补助金额较为稳定，但仍可能因政府补助的波动导致对公司的净利润产生一定的不利影响。

（二）经营风险

1、经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 22,953.42 万元、27,449.07 万元、31,230.52 万元和 23,258.64 万元，整体呈增长趋势。但分产品类别来看，发行人移动数码类芯片销售额分别为 6,621.26 万元、5,874.05 万元、5,517.37 万元和 4,103.86 万元，存在一定的下降趋势；标准电源类芯片销售额分别为 7,462.86 万元、9,122.94 万元、10,721.15 万元和 6,340.76 万元，增速放缓。前述产品均是公司的主要产品，若各产品收入增长不及预期，公司经营业绩将面临一定波动。

2、供应商集中度较高的风险

报告期各期，发行人前五大供应商占比分别为 94.57%、94.82%、91.31%和 89.92%，其中最主要的供应商为华润微电子，报告期占比分别为 61.87%、61.33%、59.72%和 53.80%，主要为发行人提供晶圆生产和芯片封装测试服务。由于行业特性，晶圆生产制造和封装测试环节的投资巨大，属资本密集型行业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，从事此行业的企业较为集中，在 Fabless 模式下，集成电路设计行业公司向晶圆制造企业和封装测试企业集中采购为行业普遍现象。公司在集中采购的情况下，可能出现由于某家供应商突发性终止与发行人的合作或停止向发行人供货导致公司短期内产品供应紧张的现象，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

3、产品质量的风险

公司主要从事电源管理芯片的研发和销售，产品涵盖了智能家电、标准电源、移动数码、工业驱动等多个行业。公司所从事业务的技术含量较高，行业的进入壁垒也相对较高，但同时也对公司研发、管理提出了更高难度的要求，从而使公司存在一定的产品质量风险。

随着行业内对产品不良率要求的提高，公司将进一步加强质量控制管理，严格把控从设计、采购、测试、检验到服务的各个环节，但若在上述环节中发生无法预料的风险，仍然可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌受损。

（三）技术风险

1、技术升级迭代风险

集成电路设计行业技术不断革新，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段。倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并制定新技术的研究方向，或研发速度不及行业技术更新速度，公司可能会面临芯片开发的技术瓶颈，对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。

2、新产品研发失败风险

为了保持公司的持续盈利能力和现有产品的技术先进性，公司报告期内研发支出较大，分别为 4,116.52 万元、4,318.10 万元、4,691.90 万元和 3,437.63 万元，占营业收入的比例分别为 17.93%、15.73%、15.02%和 14.78%。集成电路设计行业需要对市场需求进行预判，研发出符合市场需求的产品，推广使用。若未来市场需求发生重大变化或公司未能开发出满足客户需求的产品，公司将存在新产品研发失败的风险，前期投入的研发费用可能无法全部收回。

3、核心技术泄密风险

芯片产品属于技术密集型产品，产品设计方案存在被竞争对手抄袭的风险。发行人通过为相关技术申请专利、集成电路布图设计专有权等措施保护自主研发的技术，同时在产品的设计、生产、销售流程中通过各环节的业务分离等措施保护技术不被泄漏，但仍有可能存在知识产权被侵权的风险，从而对发行人产品的价格、技术领先程度产生不利影响。

（四）内控风险

1、规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司的业务规模持续扩大，营业收入分别为 22,953.42 万元、27,449.07 万元、31,230.52 万元和 23,258.64 万元，各期末总资产分别为 24,895.63 万元、27,226.51 万元、32,738.33 万元和 49,608.29 万元。随着公司业务不断发展、募集资金投资项目实施，公司收入规模、资产规模持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模扩张及时调整完善，将使公司一定程度上面临规模扩张导致的管理风险。

2、核心技术人员和管理人员流失的风险

公司所处的芯片行业处于快速发展的阶段，对技术人才和管理人员的需求较大，因此核心技术人才和关键管理人员对公司的发展至关重要，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。

人员的正常有序流动不会对本公司经营业绩造成重大影响，但如果核心技术人员和关键管理人员短期内大批流失，仍可能对本公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。

3、实际控制人风险

发行前，张立新先生持有本公司 40.54%股权，为公司实际控制人。本次发行完成后，预计张立新先生持股比例为 30.41%，仍对公司重大经营决策有实质性影响。若实际控制人用其控股地位，对公司经营决策、利润分配等重大事项进行干预，将可能损害公司其他股东的利益。

（五）募集资金投资风险

本次募集资金拟投资于大功率电源管理芯片开发及产业化项目、工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金，投资总额分别为 17,566.35 万元、15,515.14 万元、7,495.09 万元和 16,000.00 万元。项目具体实施时仍然可能面临开发技术升级、产业政策变化、市场环境变化以及人才储备不足等诸多不确定性因素，因而存在募投项目无法达到预期效果的风险。此次募投项目中，大功率电源管理芯片开发及产业化项目及工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目费用性支出较大，固定资产折旧、无形资产摊销金额较大，新开发的芯片产品存在适销性风险，一旦募集资金投资不能实现预期收益，将对公司的持续盈利能力产生不利影响，甚至出现利润下滑的风险。

（六）发行失败风险

根据相关法规要求，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应该中止，若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利条件，或将会出现发行失败的风险。

（七）本次发行股票摊薄即期回报的风险

公司总股本为 8,460.00 万股，本次预计发行股份数量为 2,820.00 万股，预计发行完成后公司总股本将增至 11,280.00 万股，增加 33.33%。截至 2019 年 9 月

30 日，公司归属于母公司股东的所有者权益为 44,658.56 万元，本次发行完成后，公司归属于母公司股东的所有者权益将增长。本次发行完成后，公司发行在外的股份数量和所有者权益将有所增加，由于募集资金投资项目的效益需要在实施过程中逐步体现，公司短期内每股收益、净资产收益率等即期回报指标会下降。请广大投资者注意即期回报被摊薄的风险。

十、关于发行人发展前景的简要评价

（一）发行人所处行业具有较强的发展前景

1、中国集成电路市场增长迅速，2018 年行业规模达 6,532 亿元

中国集成电路行业起始于上世纪末，自 2000 年颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，国家相继颁布多项政策大力扶持和推动集成电路行业发展。此外，国民经济的快速发展、互联网信息产业对传统经济的持续深入改造以及发达国家集成电路产业逐渐向发展中国家转移等因素进一步促进了国内集成电路产业的发展。

近年来我国集成电路产业发展较快，集成电路产业销售额由 2012 年的 2,158.5 亿元增长至 2018 年的 6,532.0 亿元，年均复合增长率为 20.27%。

2、中国集成电路进口量巨大，近年来国产品牌替代明显

海关总署统计快讯显示，2018 年中国集成电路进口额高达 3,120.6 亿美元，是中国进口金额最高的商品，超过原油、农产品和铁矿石的进口额。而同期中国集成电路出口额为 846.4 亿美元，贸易逆差 2,274.2 亿美元。预计未来几年，中国集成电路进口额仍将维持高位。

与此同时，近年来随着中国集成电路产品的品质和市场认可度日渐提升，集成电路国产产品对进口产品的替代效应明显。2012 年至 2018 年，中国集成电路产业销售额年均复合增长率为 20.27%，显著超过同期中国集成电路进口额复合增长率 8.43%。即便是集成电路进口增速较快的 2016 年至 2018 年，集成电路产业销售额年均复合增长率 22.74%，仍超过同期集成电路进口额复合增长率 17.23%。

3、中国集成电路行业中集成电路设计业占比最高，2018 年占比 38.57%

中国半导体行业协会将集成电路行业划分为集成电路设计业、集成电路制造业、集成电路封装测试业。集成电路设计业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，处于产业链的上游。集成电路设计企业往往具有人才密集、技术密集、资本密集等特点，对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力和产业链整合能力有较高要求，集成电路设计水平的高低决定了芯片的功能、性能及成本，集成电路设计企业的发展直接影响了制造和封装等产业链上下游众多环节。

国内集成电路设计行业起始于上世纪末，自 2000 年《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》颁布以来，近二十年间国家相继出台了多项政策推动集成电路设计行业的发展和壮大。经过数年的培育，行业进入快速成长期，市场规模快速增长。

2018年中国集成电路设计行业的销售收入为2,519.3亿元，同比增长21.50%，占 2018 年中国集成电路行业销售额比重为 38.57%，2012 年至 2018 年的复合增长率为 26.27%，我国集成电路设计业销售收入呈快速上升趋势。

（二）发行人具有较强的竞争优势

1、基于核心技术平台的产品布局和阶梯式增长模式

（1）国内首创的“高低压集成技术平台”

公司成立之初，专注于技术平台的开发，对当时国内空白、难度很大的“700V 单片高低压集成技术平台”启动研发，从特殊高压半导体工艺和器件平台技术开始研发试验，再到电路、版图和系统设计，历时两年，研发完成了 700V 单片 MOS 集成 AC-DC 电源芯片系列，能够很好地帮助整机客户达到全球日益严苛的电子设备电源待机功耗标准，并在中小功率段提供外围极为精简、小体积的电源芯片方案，打破了进口产品的垄断。多年来，公司对该技术平台持续投入，迭代更新，目前量产品种已逐步从第三代“智能 MOS 超高压双片高低压集成平台”，升级至第四代“智能 MOS 数字式多片高低压集成平台”。公司通过持续的研发投入保证核心技术平台的先进性，以保证芯片产品的技术优势。

（2）基于技术平台的产品布局和阶梯式增长模式

基于不断升级的核心技术平台，公司产品线不断丰富，收入规模和盈利水平稳步上升。2008 年基于自主研发的“高低压集成技术平台”开发的产品在家电领域取得了行业龙头客户的认可，替代进口产品，后续在行业龙头客户的示范作用下逐步在家电领域取得优势地位；2010 年，基于第二代“高低压集成技术平台”，公司开始布局标准电源芯片市场，并于 2014 年开始持续快速增长；2013 年，基于第三代“高低压集成技术平台”，公司正式切入工业驱动芯片市场，并于 2014 年在国内创先量产了内置 1000~1200V 智能 MOS 的超高压 AC-DC 电源芯片，成功进入国网/南网的智能电表和智能断路器市场，率先实现了电表中高压电源芯片的进口替代，产品线进一步丰富，业务规模快速增长。2016 年发行人基于第四代“高低压集成技术平台”，继续开发了高集成度家电电源芯片系列，成为市场上外围器件最为精简的芯片方案之一，并且其高可靠性得到了众多标杆客户的量产认可，使得公司在家电市场的占有率进一步扩大。2017 年公司针对智能大家电市场的高耐压宽输出开关电源芯片系列持续上量，凭借其在同等功率下耐压裕量更高、方案体积较小的优势，受到大家电客户的欢迎；针对标准电源类芯片市场，公司基于储备的数模混合功率技术，推出体积更小充电更快的大电流快充电源芯片，可迅速进入手机市场中高端客户。2019 年公司针对工业级通讯电源市场，开发了新一代高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理芯片，为工业级通讯设备电源管理芯片领域实现进口替代、自主可控做出贡献。

延续上述业务增长路径，发行人基于核心技术平台不断拓展新的产品线，扩大下游行业应用范围，实现阶梯式稳步增长。

2、基于行业标杆客户的产品推广模式

（1）产品得到多个下游应用行业的知名标杆客户的认可

发行人产品主打进口替代，最大的障碍是客户对发行人品牌的信任度。凭借出众的产品性能、持续的技术创新以及快速的服务响应，发行人率先突破下游行业的标杆客户，以此带动对行业内其他客户的销售。在整机/模块产品中加载了公司电源管理芯片的知名终端客户主要包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等。知名客户的认可是打入进口品牌所控制市场的

前提，为发行人的业务发展打开了广阔的空间。

（2）基于标杆客户拓展产品类别，提升技术水平

下游应用行业的标杆客户收入规模大、产品种类齐全，是下游行业产品发展的引领者。发行人与下游标杆客户合作，往往从某一型号单品开始，在该单品合作稳定、产品得到客户认可后，逐步扩大到某一品类，进一步覆盖至多个品类，直至参与到终端客户的新产品开发过程中，引导客户升级至发行人的半定制开发的电源方案，使客户整机产品性能更加优异，真正实现与终端客户的深度合作。以美的为例，发行人从电磁炉产品开始合作，目前已扩展至智能电饭煲、电压力锅、破壁机、油烟机、空调扇、直流风扇、吸尘器、洗碗机、洗衣机、冰箱、空调等多种家电，并持续开发适用于下一代家电的各类电源管理芯片。

通过该类合作，发行人自身的产品类别得到极大的丰富，可以向同一客户提供多种产品方案，实现更高效率的销售协同。同时也有助于自身技术发展更贴近下游客户的需求，加深客户理解，使得竞争对手更难追赶。

（3）基于标杆客户拓展行业内其他优势客户

发行人向行业标杆客户批量销售，标志着产品的技术水平和质量得到了行业标杆客户的认可，有利于得到下游行业其他客户的认可，引导其替代进口产品。同时，在各类新型电子产品层出不穷的今天，行业标杆客户也是新产品的引领者，新产品推出后，其他客户会快速跟进开发，其在选择供应商时会首选标杆产品的供应商。通过行业标杆客户的带动，有利于发行人实现在下游应用行业的快速突破。例如，在智能家电领域，发行人率先与美的合作，目前发行人在该领域已拓展至业内大部分的家电行业知名客户，发行人产品在智能家电行业的优势进一步巩固。在标准电源和工业驱动领域，发行人也采用相似的发展战略，即努力紧贴行业标杆客户，持续投入研发，不断推出针对性的新产品，以技术和产品为先导，开拓市场；在标准电源领域，发行人与机顶盒及路由器行业内标杆厂商合作，批量供应多款电源管理芯片。

3、产品稳定性高，品类齐全

（1）注重生产工艺研发，形成独有工艺，产品成本较低，稳定性较高

公司所处的集成电路设计行业中多数企业都采用 Fabless 模式运营，通常只专注于芯片产品电路和版图设计，缺乏对上游生产相关的半导体器件和工艺方面的研发人才，导致产品性能和品质很大程序受限于上游生产企业的技术工艺水平。

和大多数芯片设计企业不同的是，发行人除了芯片设计人才之外，还拥有半导体器件和工艺制造方面的专家团队，在晶圆制造工艺和半导体器件技术方面积累深厚，因此公司在产品生产环节中能够更好地与晶圆供应商深度协同，指定供应商采购符合芯片性能的原料，制定更优的器件结构，与供应商共同研发优化改进晶圆供应商的工艺流程并形成独有的工艺从而对竞争对手形成技术壁垒，通过质量工程师对芯片的器件工艺参数进行及时质量监控，并定期对供应商的内部质量系统运作情况进行审核把关，从晶圆生产加工方面提升了芯片的性能和可靠性，通过量产前严格的试产检验，降低早期失效的几率，保证产品的质量、降低生产成本。

基于对半导体器件和工艺的研发和积累，公司能够屡次成功与晶圆制造厂商密切配合，在国内率先开发成功并量产了业内先进工艺水平的单芯片 700V、200V、1000V 高低压集成开关电源等产品，显著提高了公司产品竞争力，其优良品质和性能得到众多知名终端客户的认可。

（2）多样化的电源芯片种类布局，应用领域广泛，市场潜力巨大

公司目前在产的电源管理芯片共计超过 500 个型号，主要产品覆盖了电源管理芯片的大部分技术种类，包括 AC-DC 芯片、DC-DC 芯片、PFC 芯片、LDO 芯片、电池充放电控制芯片、栅驱动芯片、接口控制芯片等。其中公司的 AC-DC 芯片、DC-DC 芯片以及栅驱动芯片的市场规模和技术优势相对较大。

公司产品应用市场覆盖了智能家电、移动数码、标准电源市场以及工业驱动等重点领域，随着公司产品线的丰富完善，已从过去单一提供一款电源管理芯片，发展为向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、栅极驱动等多个电源管理芯片，缩短了终端客户的开发周期，显著提升了公司各产品线的协同效应，提升了销售效率。例如，发行人积极服务国内行业标杆客户，在芯片研发阶段即针对行业标杆客户需求设计，发行人

提供的电源管理芯片及全套应用方案稳定性强、精简度高、实用性好，具备较强的竞争力。以行业标杆客户为应用示范，中小客户可参照发行人提供的成熟应用方案直接生产产品，从而进一步增强了发行人在各中小终端客户的市场推广。

4、技术研发优势

（1）强大的研发和管理团队

公司成立 10 多年来始终专注于电源管理芯片研发，以自主创新为经营核心宗旨，研发实力突出，特别在高低压集成半导体技术方面处于业内领先。公司享受国家规划布局内重点集成电路设计企业税收优惠，是高新技术企业，并参与了《家用电器 待机功率测量方法》、《智能家用电器通用技术要求》和《智能家用电器系统架构和参考模型》等多项国家技术标准的起草制定，获得了“第六届中国半导体创新产品”、2019 年第十四届“中国芯-优秀技术创新产品奖”等多项行业荣誉奖项和国家重点新产品认定。公司拥有博士后企业工作站和江苏省功率集成电路工程技术中心。

公司核心管理团队主要毕业于国内集成电路人才的摇篮东南大学，共同学习、研发、工作近 30 年，长期保持稳定。目前，公司已形成了一支拥有 2 名博士、25 名硕士、共计 104 人的研发团队，占公司员工比例 69.80%。

（2）持续的研发投入及丰富的技术积累

公司自成立以来一直重视研发投入，报告期内公司研发费用投入分别为 4,116.52 万元、4,318.10 万元、4,691.90 万元和 3,437.63 万元，平均占公司营业收入的比例为 15.79%。截至 2019 年 9 月 30 日，公司累计取得国内外专利 59 项，其中发明专利 51 项，另有集成电路布图设计专有权 76 项。公司在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势，多项芯片产品为国内首创，替代进口品牌，快速占领市场。

5、产业链协同和区位优势

公司位处江苏省无锡市，是中国集成电路产业的传统优势区域，周边配套产业链完备，有利于公司与上游芯片制造、封装厂商实现产业链协同。公司与华润

微电子、南京华瑞微、天水华天、长电科技等业内主流晶圆制造及封装测试厂商建立起了密切的合作关系，共同开发了多种特色工艺，更好地保证了公司产品的工艺优势，实现了公司产品的供货及时性、高可靠性和低上机失效率。

经核查，本保荐机构认为：发行人具有较好的发展前景。

（以下无正文）

【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行保荐书》之签章页】

项目协办人签名	卞大勇 2019 年 12 月 12 日
保荐代表人签名	陈　坚 黄　萌 2019 年 12 月 12 日
内核负责人签名	张晓宣 2019 年 12 月 12 日
保荐业务负责人签名	李华强 2019 年 12 月 12 日
董事长（法定代表人）兼首席执行官签名	林　立 2019 年 12 月 12 日
保荐机构公章	华林证券股份有限公司 2019 年 12 月 12 日

华林证券股份有限公司
关于无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐代表人专项授权书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》及有关文件的规定，我公司授权陈坚、黄萌担任无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人，负责该公司发行上市的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

特此授权。

（以下无正文）

【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人专项授权书》之签章页】

保荐代表人：

陈　坚　　黄　萌

法定代表人或授权代表：

林　立

华林证券股份有限公司（公章）

2019 年 12 月 12 日